



KC ČIP.SI
SLOVENSKI KOMPETENČNI
CENTER ZA ČIPE

NOVIČNIK

Petek, 14. avgust 2026

Pozdravljeni,

tudi v teh vročih poletnih dneh vam pošiljamo pregled zanimivih novic, vsebin in dogajanj s področja čipov in polprevodnikov.

Želimo vam prijetno prebiranje vsebin, ki smo jih pripravili za vas.

Dogodki KC Čip.si:

- Webinar: **Predstavitev Synopsys EDA rešitev za akademsko in raziskovalno okolje** 16. septembra, 2026, 13:00 – 14:00 h, on-line
Jezik webinarja: angleščina
Na webinarju bodo predstavniki podjetja Synopsys predstavili produkte in rešitve za uporabo v akademskem okolju.
Glavni namen dogodka je poleg uvodne predstavitve rešitev podjetja Synopsys prepoznati možnosti za vključevanje predstavljenih orodij in tehnologij v izobraževalni proces ter raziskovalno delo.
Poseben poudarek bo namenjen uporabi profesionalnih industrijskih orodij pri poučevanju, izvedbi študentskih projektov ter raziskavah na področjih mikroelektronike, načrtovanja integriranih vezij, elektronike, računalniškega inženirstva, telekomunikacij in drugih sorodnih tehničnih ved.
S strani podjetja Synopsys bosta sodelovala Mr. Patrick Haspel in Mr. Navid Manai.
Dogodek je namenjen predstavnikom izobraževalnih ustanov, raziskovalnih organizacij, profesorjem, raziskovalcem in drugim strokovnim sodelavcem s področja izobraževanja in raziskovanja.



Prijava na webinar tukaj

Dogodki:

- Poziv k prijavi na izobraževanje: **ASIC Design Introduction: From Concept to Silicon**
24.-28. avgust, 2026, Leuven, Belgija
Tečaj udeležence seznani s ključnimi vidiki razvoja integriranih vezij (ASIC), od načrtovanja do testiranja in integracije. Namenjen je strokovnjakom, ki želijo razširiti svoje znanje na področju mikroelektronike.
Program izobraževanj si ogledate lahko na [povezavi](#).
Cena izobraževanja: 750 €
Na izobraževanje se lahko do **18. avgusta, 2026**, prijavite [tukaj](#).
- Konferenca: **PRIZE FOR THE BEST INNOVATION WITH COMMERCIAL POTENTIAL IN 2026**
7. oktober, 2026, Novo Mesto, Slovenija
Na konferenci bo podeljena posebna nagrada za inovacije javnih raziskovalnih organizacij. Udeleženci bodo svoje tehnologije predstavili komisiji vlagateljev in strokovnjakov za prenos tehnologij, ki bo ocenjevala njihov tržni potencial ter nagradila najbolj obetavne inovacije.
Program vključuje pripravljalne delavnice za prijavo, individualna svetovanja, trening predstavitve (pitcha) ter zaključni nastop pred ocenjevalno komisijo na dogodku ITTC19 v Novem mestu.
Nagradni sklad: 3.000 EUR.
Podroben program konference si lahko pogledate – [tukaj](#) in celote poziv pa tu.
Rok za oddajo prijav je 2. september 2026. [Povezava na registracijo](#).

Novice:

- **Tyndall hails record year as three chip start-ups launched**
Irski raziskovalni inštitut Tyndall National Institute je v letu 2025 ustanovil tri nova zagonska podjetja s področja polprevodnikov, ki so bila izbrana v program ChipStart EU, prvi evropski inkubator za polprevodniške startupe. Dosežek potrjuje krepitev ne zgolj irskega, ampak tudi evropskega polprevodniškega ekosistema in predstavi pomembno vlogo raziskovalnih organizacij pri prenosu tehnologij na trg.
- **A new way to watch heat move through electronics**
Raziskovalci na MIT so razvili novo metodo za spremljanje širjenja toplote v večplastnih polprevodniških strukturah z uporabo ultrahitrih rentgenskih žarkov in laserskih pulzov. Tehnologija omogoča natančnejše odkrivanje lokalnih pregrevanj in bi lahko prispevala k razvoju zmogljivejših in energetsko učinkovitejših čipov.
- **Innovative design unlocks resilient semiconductor materials**
Raziskovalci so razvili nov oksidni polprevodnik z obetavnimi električnimi in termoelektričnimi lastnostmi, ki bi lahko prispeval k učinkovitejši pretvorbi odpadne toplote v električno energijo ter k razvoju odpornejše elektronike.
- **Imperial engineers build a reconfigurable photonic quantum chip**
Nov fotonski kvantni čip Clavin omogoča prilagodljivo izvajanje različnih kvantnih operacij brez sprememb strojne opreme. Nova arhitektura predstavlja pomemben korak k bolj vsestranskim kvantnim računalnikom.
- **Researchers develop a new way to build molecular 'ladders' for organic electronics**
Razvita je nova metoda za natančno izdelavo t. i. molekularnih »lestev«, ki omogoča boljši nadzor nad elektronskimi lastnostmi organskih materialov. Preboj bi lahko prispeval k razvoju zmogljivejših organskih polprevodnikov.

za fleksibilno elektroniko, senzorje in druge napredne elektronske naprave.

Želimo vam uspešen zaključek tedna,
ekipa KC Čip.si



Slovenski kompetenčni center za čipe in polprevodniške tehnologije

KC Čip.si - glavna pisarna

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Tržaška cesta 25, Ljubljana

E-pošta: office@cc-chip.si

Tel.: 01 476 88 50

Spletna stran: <https://cc-chip.si/>



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO

Projekt CC Chip.si (št. 101217674) je sofinanciran s strani Chips Joint Undertaking in Evropske unije v okviru programa Digital Europe.

To sporočilo ste prejeli, ker ste se prijavili na prejemanje novic KC Čip.si ali izrazili interes za obveščanje o naših dejavnostih.

Če novic ne želite več prejemati, se lahko kadarkoli odjavite.

[Odjava](#)



